



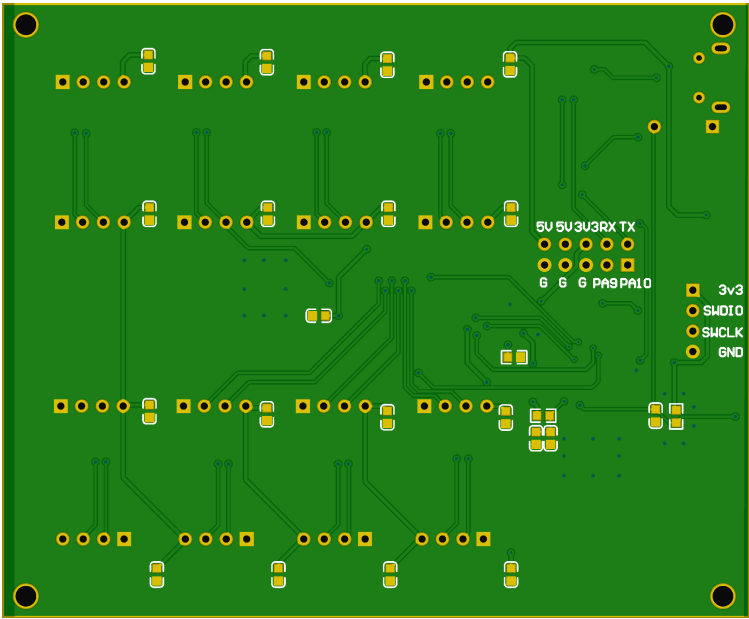
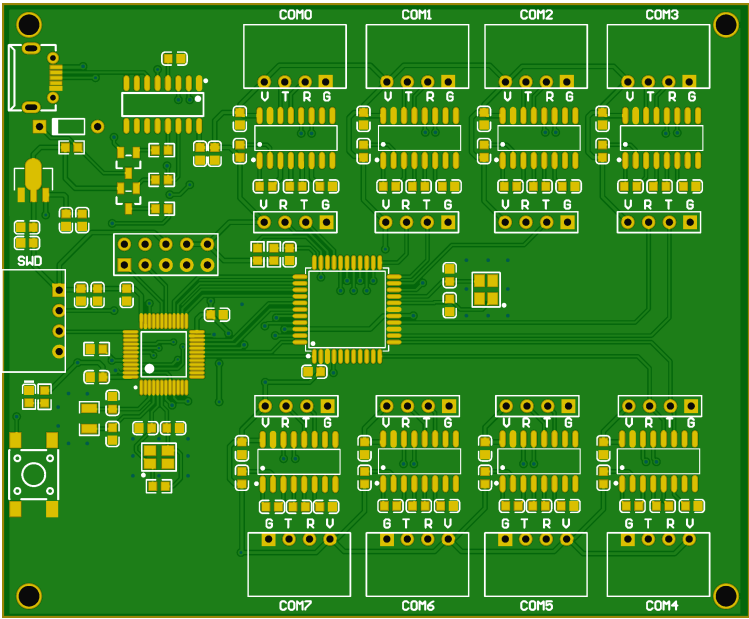
检查报告

时间2022-02-27

文件名: PCB

层数: 2

尺寸: 91.44*75.18 mm



警示项

报告项目	类型	分析结果	描述与建议
板边距离	铜/PAD/线到板边距离	板边异常	<p>外形（板框）用于机械成型，焊盘、铺铜及走线都应避开外形线，避免出现锣断线或露铜的情况。</p> <p>铜、焊盘、导线到板间距$\geq 15\text{mil}$</p> <p>业内绝大多数工厂的锣边极限为8mil，小于该极限值，有露铜甚至断线的隐患；您的“导线/焊盘/覆铜到板边”最小间距为0.00mil，建议$\geq 10\text{mil}$；如是V割边，建议$\geq 15\text{mil}$，具体极限值与板厚、V刀角度有关，规则请查看“DFM文档”</p>
阻焊开窗	阻焊盖线	阻焊异常	<p>阻焊窗口覆盖走线，导致走线裸露，不同网络之间的线裸露后有短路的风险。</p> <p>走线裸露</p> <p>阻焊窗口</p> <p>您的文件“阻焊到线”小于0.34mil，走线被裸露可能会造成短路，影响产品电气性能。建议$\geq 0.08\text{mm}$</p>

全部检查项

报告项目	类型	分析结果
------	----	------

电气信号	断头线	✔ 正常
	孤立铜	✔ 正常
	无效过孔	✔ 正常
	片式SMD没连线路	✔ 正常
	锐角	✔ 正常
最小线宽	最小线宽	✔ 正常
最小间距	线到线	✔ 正常 0.152098 mm
	盘到线	✔ 正常 0.152098 mm
	盘到盘	✔ 正常 0.152098 mm
最小焊盘	BGA焊盘	✔ 正常
	常规焊盘	✔ 正常
	长条焊盘	✔ 正常
SMD间距	同网络SMD焊盘间距	✔ 正常
	不同网络SMD焊盘间距	✔ 正常 0.249936 mm
	同器件焊盘间距	✔ 正常
	不同器件焊盘间距	✔ 正常
网格铺铜	网格线宽	✔ 正常
	网格线距	✔ 正常
孔大小	最小孔径	✔ 正常 0.3048 mm
	最大孔径	✔ 正常
	厚径比	✔ 正常
槽孔	最小槽宽	✔ 正常 0.700024 mm
	最大槽宽	✔ 正常
	槽长宽比	✔ 正常

孔环	过孔孔环	✔ 正常
	插件孔孔环	✔ 正常
孔到孔	同网络过孔	✔ 正常
	不同网络过孔	✔ 正常
	插件孔	✔ 正常
孔到线	过孔到表层	✔ 正常 0.304648 mm
	插件孔到表层	✔ 正常
	过孔到内层	✔ 正常
	插件孔到内层	✔ 正常
	NPTH到铜	✔ 正常
板边距离	铜/PAD/线到板边距离	❗ 2pis 板边异常
	SMD到板边距离	✔ 正常
	孔到板边	✔ 正常
特殊孔	半孔	✔ 正常
	盲埋孔	✔ 正常
	盲埋孔距离	✔ 正常
	激光孔	✔ 正常
	正/长方形孔	✔ 正常
焊盘规格	焊盘大小异常	✔ 正常
	封装内间距异常	✔ 正常
孔上焊盘	盘中孔	✔ 正常
	插件孔	✔ 正常
	过孔上焊盘	✔ 正常
	非金属孔	✔ 正常

阻焊开窗	阻焊异常	✅ 正常
	阻焊盖线	❗ 2pis 阻焊异常
	阻焊间隙	✅ 正常
	同网络阻焊间隙	✅ 正常
	漏阻焊桥	✅ 正常
	同网络漏阻焊桥	✅ 正常
孔密度	孔密度	❗ 184个; 2.68万/m²
沉金面积	沉金面积	❗ 16.64%
飞针点数	飞针点数	❗ 627
Mark点	Mark点	✅ 正常
锣长分析	锣长分析	❗ 49.6738m/m²